

# 三次元光実装に向けたマイクロレンズの エッチングプロセスと評価



SATテクノロジー・ショーケース2025

## ■ はじめに

電気素子と光素子を同一基板上に実装する光実装分野 では、集積回路上のシリコン系光導波路と光ファイバーを 近接して配置するためには、ポリマー光導波路を介して3 次元で結合する必要がある。しかし、シリコン系光導波路と ポリマー光導波路の寸法が1桁違うことや、設置する高さが 異なることから、段差を乗り越えての直接的な結合は困難 である。我々は、これまで光硬化法を用いてマイクロレンズ を3次元造形する方法で、研究開発[1]を推進してきた。今 回、シリコン系光導波路に近接して設置するマイクロレンズ を、半導体の異方性エッチングを利用して形成したので報 告する。

## ■ 実験方法

今回の実験では、Si基板上に直径が40µm、20µm、10µm のマイクロレンズを2種類のエッチングプロセスで試作した。 パターンの半径やエッチングプロセスによってマイクロレン ズの集光性を示す指標となる曲率半径にどのような影響が 出るのかを調べた。エッチングマスクにはエッチング選択 比より酸化アルミニウム(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)を採用した。

#### 1. レジストパターンの形成

ポジ型のレジストをスピンコート法にて均一に塗布したの ち、電子線描画法により露光を行った。使用した装置は CRESTEC社製の型式:CABL-200である。

# 2 酸化アルミニウムエッチング

エッチングマスク材料であるAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を2種類の方法でエッチ ングした。1種類目は、エッチングガスにCHF。を利用した 場合である。この方法では、フッ化物が堆積したため、エッ チングレートが0.7nm/minと遅く、改善が必要な状況であっ た。2種類目は、CHF3とO2の2種類のガスを混合したエッ チングである。この方法では、酸素を加えたことによりレジ ストの変性が低減され、エッチングレートが20nm/minと改 善された

# 3. Siエッチング

全てのパターンに対してSF。ガスを用いて10分間エッチ ングを行った。このドライエッチングの異方性により、シリコ ン基板上のパターン内に凹面が形成される。

#### ■ 測定結果

表1は、エッチングガスにCHF3のみを利用した場合であり、 表2は、エッチングガスにCHF3とO2を利用した場合の結果 である。測定結果を図

1に示す。表1と表2の結果を比較すると、表1の結果では 直径の実測値と設計値が同じだが、表2の結果では設計 値より実測値の直径が大きくなった。曲率半径の小さい結 果は、表2の条件であった。

# ■ まとめと考察

今回、直径が10、20、40µmのマイクロレンズ構造を、2種類 のAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>エッチングガスの条件で試作を行った。Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のエ ッチングガスをCHF。のみから、CHF。とO。に変更したことに より、レジストの変性と反応材料の析出を防止出来たことか ら、エッチング表面がスムーズになり、曲率半径を更に小 さくして、目標の30µm以下を実現した。課題としては酸素 を含むことからレジストが早く離れてしまうため、エッチング 時間の許容度が少ないことと、開口部の円形パターンが大 きくなってしまう事である。

### ■ 関連情報等(特許関係、施設)

[1] A. Noriki et. al., "Mirror-based silicon-photonics vertical I/O with coupling efficiency enhancement for standard single-mode fiber," J. Lightwave Technol., 38, 3147-3155 (2020).

・産業技術総合研究所 ナノプロセシング施設

表1 エッチングガスが CHF3 の場合のエッチング形状

	直径の実測値[µm]	曲率半径の平均値[µm]
10um	9.3	24.1
20um	20.3	27.9
40um	40.3	85.9

表2 エッナングガスが2種類混合のエッナング形状

	直径の実測値[µm]	曲率半径の平均値[µm]
10um	19.7	13.8
20um	31.1	26.9
40um	51.6	73.0

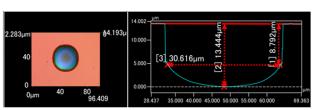


図1 シリコンマイクロレンズの測定結果例

菊地 奎人(きくち けいと) 代表発表者

東京都市大学 総合理工学研究科 情報専攻 所

産業技術総合研究所 プラットフォームフォト ニクス研究センター 光実装研究チーム

〒158-8557 東京都世田谷区玉堤1丁目 問合せ先 28-13 号館 2 階

TEL: 03-5707-2181 E-mail: g2481415@tcu.ac.jp ■キーワード: (1) 光実装

(2)マイクロレンズ (3)ドライエッチング

■共同研究者: 板谷 太郎 産業技術総合研究所 天野 健 産業技術総合研究所 岡野 好伸 東京都市大学